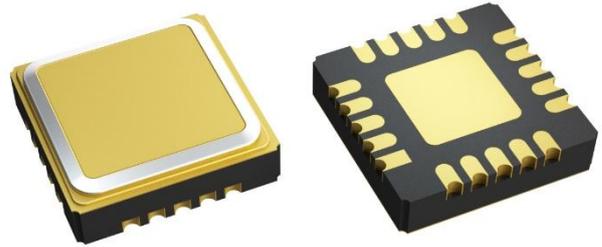


特点:

- 频率范围: 0.1~4.0GHz
- 插入损耗: 典型值1.5dB
- 隔离度: 典型值40dB
- 开关时间: 典型值60ns
- 单刀四掷吸收式
- QFN 金属陶瓷封装
- 尺寸: 4.0×4.0×1.5mm

图片:

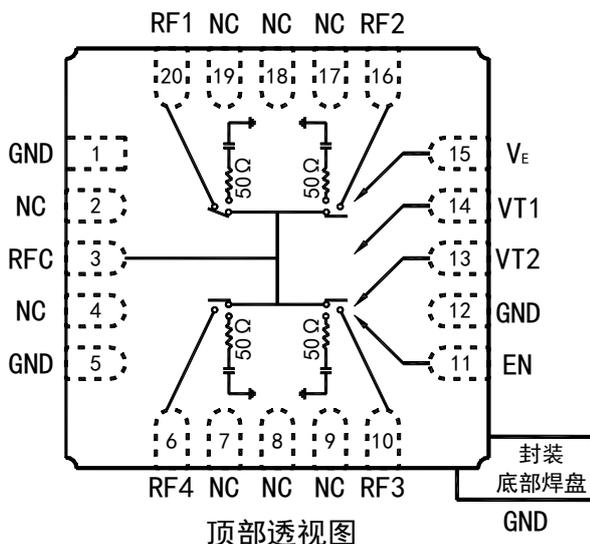


性能参数: (50Ω系统, T_A=-55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注	
			MIN	TYP	MAX			
频率范围	f	V _E =-5.00V f= 0.1~4.0GHz P _{IN} =0dBm 控制电平: 0 /+5.0V	0.1		4.0	GHz		
插入损耗	IL			1.5	2.0	dB		
端口驻波比	VSWR				1.5:1	2.0:1		
隔离度	ISO			25	40		dB	
输入-1dB 压缩点	IP-1dB			+20	+26		dBm	
开关时间 ^①	t				60	90	ns	
上升沿	t _{RISE}				30	35	ns	10% RF~90% RF
下降沿	t _{FALL}				30	35	ns	90% RF~10% RF
控制电平	V _{TH}			+3.3	+5.0	+5.0	V	
	V _{TL}			0		+0.5	V	
电源电压	V _E		-4.75	-5.00	-5.25	V		
工作电流	I _E			8	10	mA		
质量	m				1	g		

注: ①开关时间: 开通时间=50% Ctrl~90% RF, 关闭时间=50% Ctrl~10% RF。

功能框图:



引脚定义:

引脚编号	符号	描述
3	RFC	射频输入端口, DC 耦合
20	RF1	射频输出端口 1, DC 耦合
16	RF2	射频输出端口 2, DC 耦合
10	RF3	射频输出端口 3, DC 耦合
6	RF4	射频输出端口 4, DC 耦合
15	V _E	电源端口, -5.00V
14	VT1	控制端口, 0 /+5.0V
13	VT2	控制端口, 0 /+5.0V
11	EN	控制端口, 0 /+5.0V
2/4/7/8/9/17/18/19	NC	悬空, 建议接地
1/5/12	GND	接地
底部中央焊盘	GND	接地

极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+23dBm
电源电压	0~-5.5V
控制电压	0~+5.5V
装配温度	+260°C, 20s
工作温度	-55~+85°C
贮存温度	-55~+125°C
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。

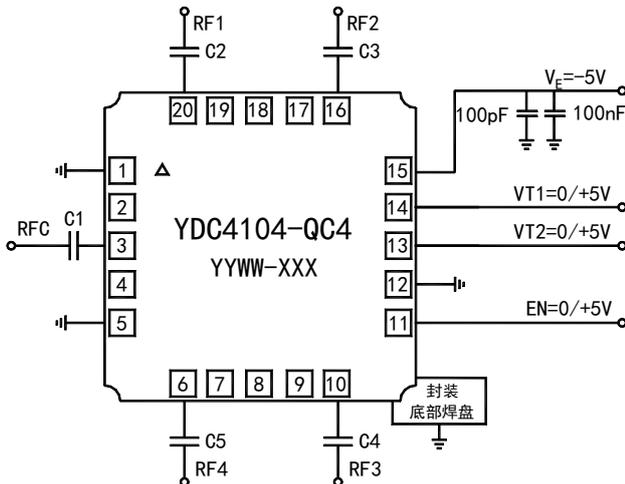
真值表: (0: 0V, 1: +5.0V)

控制输入			射频通路			
VT1	VT2	EN	RFC-RF1	RFC-RF2	RFC-RF3	RFC-RF4
0	0	0	导通	关断	关断	关断
0	1	0	关断	关断	导通	关断
1	0	0	关断	导通	关断	关断
1	1	0	关断	关断	关断	导通
0	0	1	关断	关断	关断	关断
1	1	1	关断	关断	关断	关断

控制电流

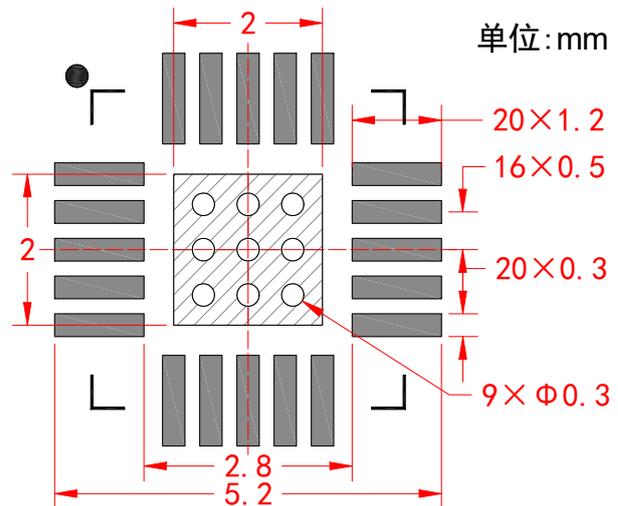
状态	电压	电流 (典型值)
VT _L	0~+0.5V	0~80μA
VT _H	+3.3~+5.0V	70~400μA

推荐应用电路:

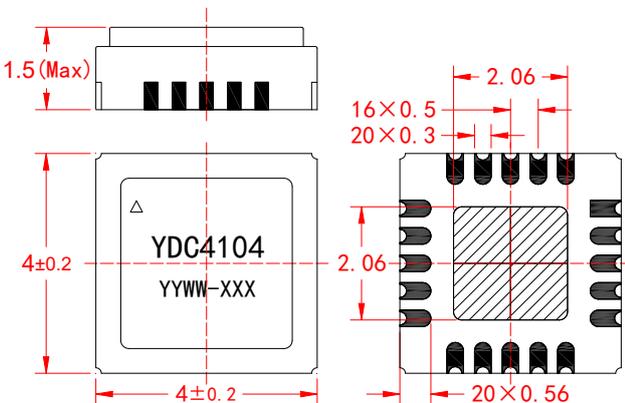


注: 耦合电容 C1、C2、C3、C4、C5 根据频率选用合适的值。

推荐焊盘图:



外形尺寸图:



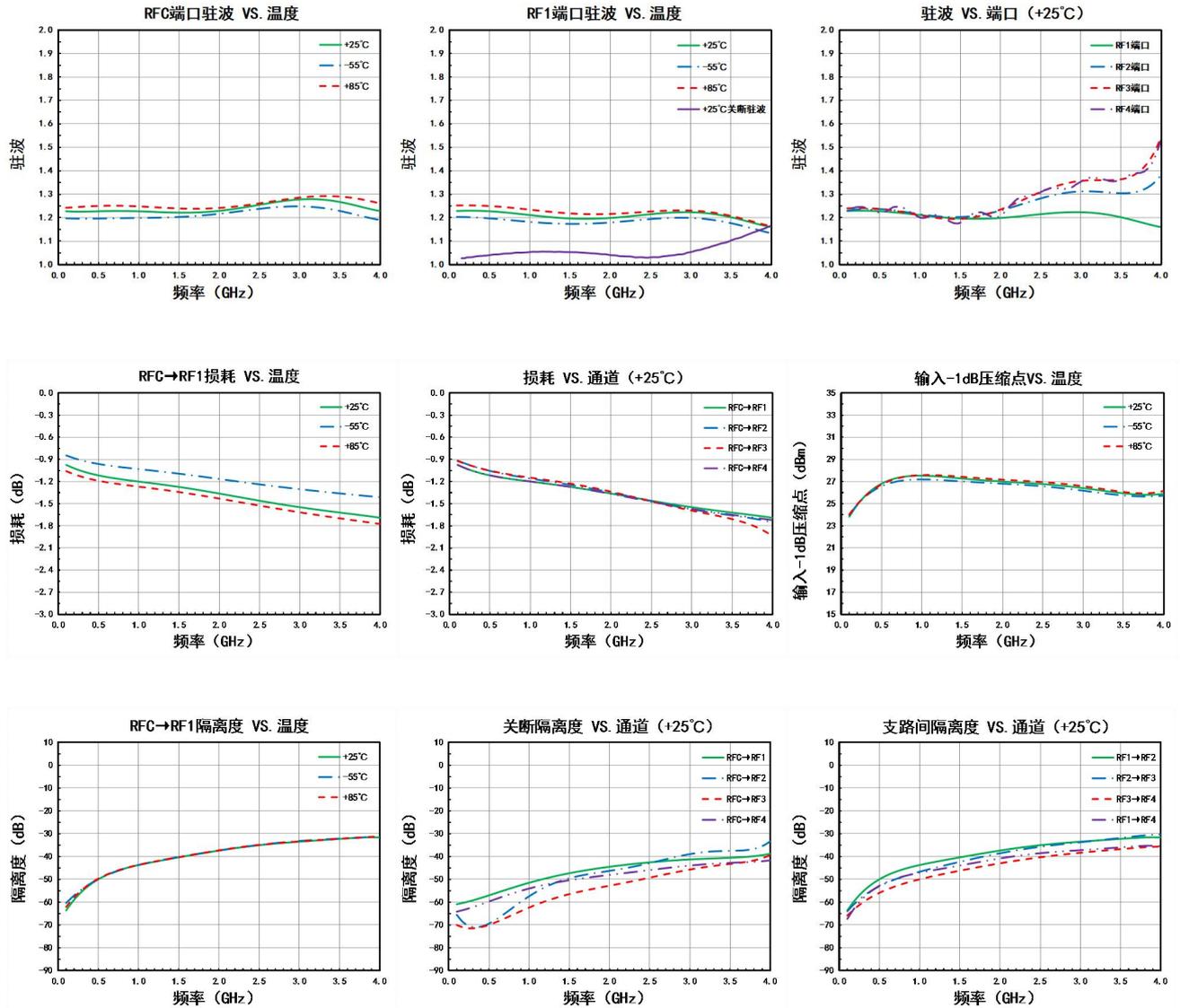
- 注: 1、单位: mm, 未注明公差按 GB/T 1804-m;
 2、产品采用气密陶瓷封装, 引脚表面镀镍金 (Ni:1.3~8.9μm, Au:1.3~5.7μm);
 3、产品标识采用激光刻字。

字符标志:

标识	说明	备注
YDC4104	产品型号	
△	1脚&静电敏感标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

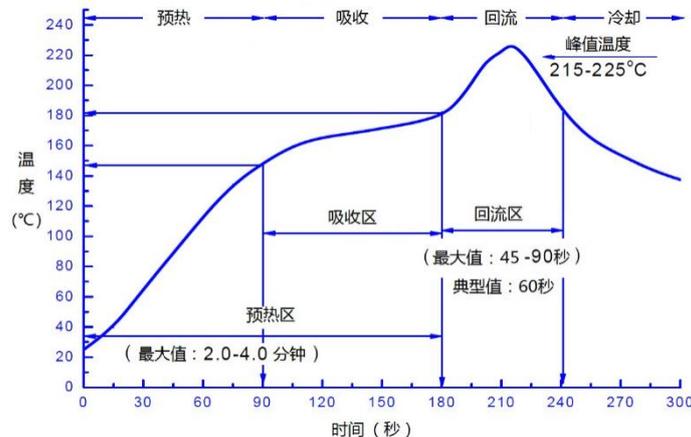


典型测试曲线：(50Ω系统, $V_E=-5.00V$, $V_T=0/+5.0V$, $P_{IN}=0dBm$)



产品使用注意事项：

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）。
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点+183°C回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

4. 如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度+350°C，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度+10~+35°C，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。